

キオクシア 現場受入型インターンシップ募集コース・テーマ一覧
半導体にまつわる研究・企画・開発・設計・製造など、さまざまなテーマをご用意しています。

<開催地詳細>

横浜 = 横浜テクノロジーキャンパス（大船）
新子安 = 新子安テクノロジープロント（新子安）
四日市 = 四日市工場（四日市）
本社 = 本社（田町）

コースNo.	テーマNo.	コース名	テーマ名	実習内容	求める知識/スキル	活かせる知識								求める人物像	開催地				
						電気電子	機械	物理・物性	化学	情報	数学	環境	建築	専攻不問	横浜	新子安	四日市	本社	
JD2_K	JD2-KY-023	JD2×京浜	最先端メモリパッケージの設計	最先端フラッシュメモリのパッケージ設計現場での実際の業務である、コンセプト/構造設計、基板設計、電気特性シミュレーション、熱構造シミュレーションの概要を体験してもらい、先輩エンジニアとのディスカッションを通して学生自らが課題解決に向けたパッケージ構造を決定するプロセスを具体的に体験していただきます。	電気電子、物理、物性、化学いずれかの基礎知識があると望ましい 上記専攻以外の出身者も多くいるため、この限りではありません。	●	●	●	●					●	・半導体に限らず、研究や開発に興味関心がある ・最新技術などの動向に興味関心がある ・失敗を恐れず、チャレンジできる ・仮説を立て実験し、分析検証することができる	●			
JD2_K	JD2-KS-026	JD2×京浜	最先端フラッシュメモリの応力シミュレーション	有限要素法構造解析を用いて3Dメモリ構造特有的変形・破壊現象の調査、構造強度設計を体験し、企業での研究開発と働き方を具体的に体験していただきます。	理学・工学またはそれに準ずる学部・専攻。有限要素法構造解析の知識があると望ましいが、この限りではない。		●	●			●		●	●	・薄膜デバイス/材料の研究や開発に興味がある ・半導体分野に限らず、新しい技術を取り入れ、チャレンジできる ・仮説を立て実験・検証し、分析することができる	●			
JD2_K	JD2-KS-027	JD2×京浜	先端半導体検査計測シミュレーション	次世代半導体メモリの微細形状の計測技術やセンシング技術について、光学シミュレーションや信号解析を用いた計測技術開発を体験し、企業での研究開発と働き方を具体的に体験していただきます。	検査計測、センシング技術に興味のある方。工学、理学またはそれに準ずる分野を専攻し、光学、X線等の知識があると望ましいが、その限りではない。	●	●	●			●			●	・研究や開発に興味関心がある ・失敗を恐れず、新しい技術にチャレンジできる ・仮説を立て実験・検証し、分析することができる	●			
JD2_K	JD2-KS-028	JD2×京浜	先端フラッシュメモリ向け低環境負荷、低コストエッチング技術開発	半導体の前工程や後工程への適用に向けて、環境負荷が小さく低コストな加工技術として、ウェットやガスによる触媒を用いたエッチングプロセスの研究開発を体験し、企業での開発環境と日々の働き方を具体的に体験していただきます	工学、理学またはそれに準ずる分野を専攻し、材料、物理の基礎知識を有することが望ましい。	●		●	●					●	・半導体プロセスの研究開発に興味関心がある ・実験から得られたデータを深く考察し、仮説を立てながら次の実験を進めることができる	●			
JD2_K	JD2-KS-029	JD2×京浜	先端プラズマCVDプロセス開発	高温プラズマCVDプロセスの基礎評価を行なう。クリーンルーム内でCVD実験機を使って成膜実験を行い、成膜された薄膜の結合状態、膜組成、膜厚等を分析する。高温化によって変化する膜質と成膜速度の相関性を評価し、高温プラズマCVDプロセスの特性を把握する。本取り組みを通して企業での研究開発と働き方を具体的に体験する。	工学、理学またはそれに準ずる分野を専攻し、材料、物理の基礎知識を有することが望ましい。	●		●	●					●	・半導体プロセスの研究開発に興味関心がある ・実験から得られたデータを深く考察し、仮説を立てながら次の実験を進めることができる	●			

JD①製品・デバイス技術開発 JD1
JD②プロセス・パッケージ技術開発 JD2
JD③システム・ソフトウェア・回路設計技 JD3
JD④顧客対応技術・評価解析・品質技術隣 JD4

横浜テクノロジーキャンKY
新子安テクノロジーフロKS
四日市工場 YY
本社 KT